

Process and R&D Status of 3D Wafer Bonding Equipment – April 19, 2023

3D晶圆键合装备的工艺流程及研发现状

[dyzacxahj059](#)来源：半导体设备与材料 · 2023-04-20 11:47 · 323次阅读 · 0条评论

硅基异构集成和三维集成可满足电子系统小型化高密度集成、多功能高性能集成、小体积低成本集成的需求，有望成为下一代集成电路的使能技术，是集成电路领域当前和今后新的研究热点。硅基三维集成微系统可集成化合物半导体、CMOS、MEMS等芯片，充分发挥不同材料、器件和结构的优势，可实现传统组件电路的芯片化、不同节点逻辑集成电路芯片的集成化，从而提升信号处理等电子产品的性价比。梳理了晶圆键合装备的工艺流程、主要厂商及市场需求、我国晶圆键合设备研发现状，并展望了晶圆键合设备的技术发展趋势。

0 引言

<https://www.elecfans.com/article/89/2023/202304202063386.html>